

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Callister, William D. 2007. *“Material Science and Engineering An Introduction”*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- [2] Kalpakjian, Serope. 1984. *“Manufacturing Process for Engineering Materials”*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- [3] Febriyandi. 2013. *“Penggunaan Gas Argon Sebagai Pelindung Pada Proses Free Vacuum Diffusion Bonding AA5052 - C10100”*. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Andalas.
- [4] Bellido, N. Hug*,E. *“Brittleness Study of Intermetallic(Cu,Al) Layers in Copper-clad Aluminium Thin Wires”*(2011)
- [5] Mahoney, Murray W & Bampton, Cliff C. 1993. *“Fundamentals of Diffusion Bonding”*. ASM Handbook. Volume 6.
- [6] Arivandovad, Zio. 2015. *“Pengaruh Temperatur Pemanasan terhadap Potensi Ketersambungan dan Kekuatan Tarik Al-Cu dengan Proses Difusi Menggunakan Tungku Perlakuan Panas”*. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Andalas.
- [7] NN, Electro Crimp Contact, <http://www.eccipl.com/product/bi---metal-tubular-connector-bi---metal-lugs-and-connectors/>, diakses pada 20 April 2015.

